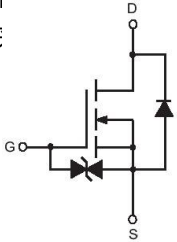




版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
			按客户要求，修改等效电路图及参数 由原来 改为	蓝月葵	刘晓荣
			修改为不带等效由路图及参数 由原: 	黄超	庞隆基
			特征栏增加无卤标示做无卤规格书	陆丽英	刘晓荣
			增加 、 、 参数	黄超	庞隆基
			型号加 ，特征及应用增加汽车产品描述（符合标准高可靠性要求、满足汽车应用的严格要求）印章 改为 ，峰值温度 ，时间持续为 更新为：峰值温度 ，时间持续为 。	黄超	庞隆基



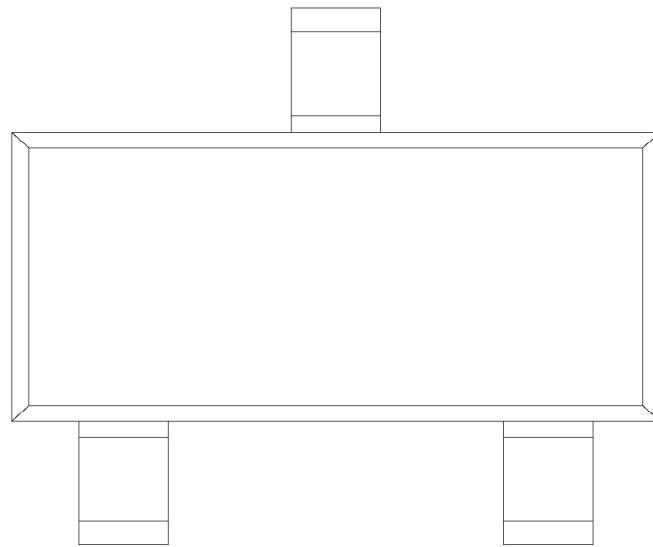
塑封封装 沟道 场效应管。

输出电阻小、性能高； 封装，利于设计安装，符合 标准高可靠性要求，无卤产品。



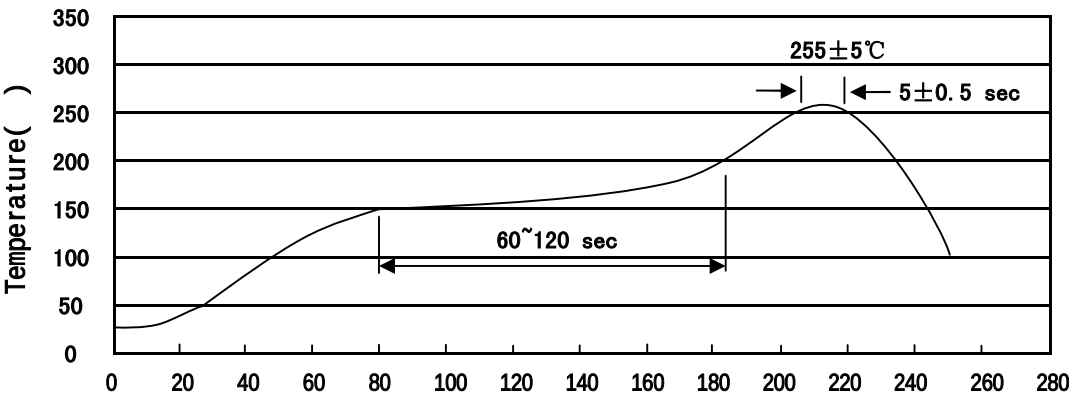
单位	参数	符号 改征要按	数值	单位

'NED [()] T J E T
3 Ø f 0 0 9 8 0 B Q s c 8





Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

温度： ± °C 时间： ± ± °C ±

卷盘包装

	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205